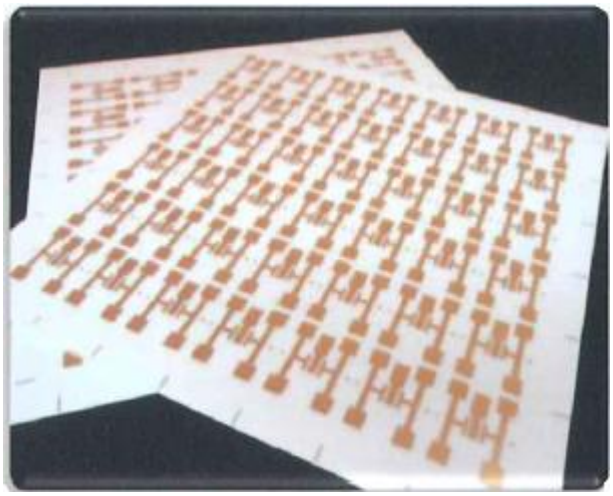
高輝度LED用セラミックシステム基板

スパッタ・フォトリソグラフィー・厚膜プロセスを融合した技術です

電解メッキによるメッキ回路厚の上昇による熱拡散の向上に対応

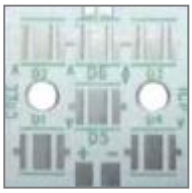
カスタマイズによるデザインと製造に対応

■特徴



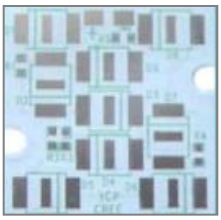
・優れた熱伝導性：Al_2O_3基板：20～27W/mK
・パッケージサイズの最小化
・優れた接合力
・高い破壊強度：15KV/mm
・表面メッキの多様性
（1）Ni/Pd/AU
（2）Sn
（3）Ag
（4）Cu　OSP
・RoHSに適合

1515



Unit size 15*15
LED chip : 3535×6

2727



Unit size 27*27
LED chip : 5050×9

5050

Unit size 50*50
LED chip : 3535×9

■アプリケーション

・LEDモジュールアプリケーション
・フラッシュライト
・ランプ
・屋外、屋内用照明

テクノアルファ株式会社　エレクトロニクスグループ
〒141-0031　東京都品川区西五反田2-27-4　明治安田生命五反田ビル
TEL03-3492-7430 FAX03-3492-2580
e-mail: nagura@technoalpha.co.jp　http://www.technoalpha.co.jp/